

investor

newsletter

IM FOKUS

- 2-3 ■ Komplettlösungen für den
Technology Lifestyle

TRENDS & THEMEN

- 4-5 ■ Speicherchips: Infineon sichert sich
Partnerschaft in China
- Infineon und Nanya: Gemeinsam zu
neuer Technologie und Chipfabrik
 - Erneut Sesames-Award für Infineon
 - Infineon und Agere: Allianz für schnelle
drahtlose Netzwerk-Lösungen
 - Infineon liefert Speicherprodukte
an Kingston
 - Gute Unternehmensführung als
ganzheitliches Konzept

ENTWICKLUNG & PRODUKTE

- 6-7 ■ Jungforscher knackt Geschwindigkeits-
rekord
- Einfacher Chat per Mobiltelefon:
Neue Systemlösung
 - Chip könnte Strichcode ersetzen
 - Durchbruch: Kostenvorsprung mit der
300-Millimeter-Technologie
 - Alles auf eine Karte: Geldbörse,
Fahrkarte und Ausweis
 - Intelligentes Autokennzeichen schützt
vor Autodieben

ZAHLEN & FAKTEN

- 8-10 ■ Bereich Speicherprodukte zurück
in der Gewinnzone

AUSBLICK

- 11-12 ■ Ausblick bis Juni 2003
- Bekenntnis zu allen Geschäftsbereichen
 - Relative Performance der IFX-Aktie
seit Beginn des GJ 02/03



Agenda 5-to-1

KOMPLETTLÖSUNGEN FÜR DEN TECHNOLOGY LIFESTYLE

Durchstarten aus der Poleposition: Infineon präsentiert Strategie „Agenda 5-to-1“

Infineon hat sich viel vorgenommen: Kurz vor Jahreswechsel hat das Unternehmen seine überarbeitete Strategie vor Finanzanalysten und Journalisten ausführlich präsentiert – mit überaus ehrgeizigen Zielen. Quantifiziert werden sie in der „Agenda 5-to-1“, und die besagt:

In den nächsten 5 Jahren wollen wir...

I zu den Top 4 Halbleiterunternehmen gehören, indem wir unseren Anteil am Weltmarkt für Halbleiter auf rund 6% verdoppeln,

I in jedem unserer Geschäftssegmente mindestens eine Top 3 Marktposition erreichen,

I bei der Ertragskraft jedes einzelnen Geschäftsbereiches eine Top 2 Position einnehmen und

I das Halbleiterunternehmen Nr. 1 im Lösungsgeschäft werden.

Das Lösungsgeschäft ist dabei Ziel und Mittel zugleich – gemeint ist, dass dem Kunden nicht allein Halbleiter-Bauelemente angeboten werden, sondern mehr und mehr maßgeschneiderte Lösungen, die ein Paket aus Halbleiterprodukt, Software, Beratung und Service beinhalten und seine individuellen Bedürfnisse erfüllen. Infineon bietet beispielsweise schon heute das komplette Innenleben für Mobiltelefone an, einschließlich Platinenlayout und Software, so dass der Kunde im Prinzip nur noch Gehäuse, Display und Akku hinzufügen muss. Diese umfassende Lösungskompetenz macht Infineon nicht zuletzt interessant für neue Kundengrup-

pen, die beispielsweise nicht über eigene Softwarekompetenz verfügen. Dass sich dieser Ansatz unternehmensweit in allen Geschäftsbereichen durchsetzt, ist ein Ziel der neuen Strategie. In Zukunft werden sich deshalb wesentlich mehr Infineon-Ingenieure mit Software-Systemen befassen.

Halbleiter-Lösungen für den Technology Lifestyle im 21. Jahrhundert

Gesucht sind dabei technologische Lösungen für das moderne Leben – getreu der neuen Unternehmens-Vision von Infineon, „Halbleiter-Lösungen zu schaffen, die den Technology Lifestyle des Menschen im 21. Jahrhundert ermöglichen“. Damit will Infineon weg von der vornehmlich technologiegetriebenen Produktentwicklung, in der das technisch Machbare das Maß der Dinge war. Vielmehr sollen sich die Produkte an den individuellen Bedürfnissen des Menschen ausrichten, unseren Alltag vereinfachen und unsere Lebensqualität verbessern. Beispielsweise mit intelligenter Kleidung: Chips können künftig in Kleidungsstücken als Herzstück eines MP3-Players dienen oder auch helfen, Personen zu orten oder Markenkleidung von Plagiaten zu unterscheiden. Chips können im Gesundheitswesen Körperfunktionen überprüfen, beispielsweise Blutdruck messen, und im Ernstfall wird mit automatischem Alarmruf Hilfe angefordert. Mobile Multimedia-Anwendungen werden künftig allgegenwärtig sein. Das ist ein Grund dafür, warum Infineon jetzt den Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen gegründet hat, der die bisherigen Bereiche Mobile Kommunikation und Sicherheits- und Chipkarten-ICs unter einem Dach zusammenbringt. Denn immer wichtiger wird im Mobilfunk die

sichere Datenübertragung, beispielsweise für mobiles elektronisches Banking, das bald überall und jederzeit möglich ist. Indem Infineon seine Kompetenz für Sicherheitsanwendungen und Mobilität verknüpft, entstehen neue Lösungsansätze – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Ein ehrgeiziges Ziel: Schneller wachsen als der Markt

Insgesamt hat sich Infineon vorgenommen, seinen Weltmarktanteil bis 2007 auf 6% zu verdoppeln. Dazu muss das Unternehmen schneller wachsen als der Markt – einerseits durch organisches Wachstum. Zum anderen setzt Infineon darauf, weitere Partnerschaften einzugehen und eher kleinere Unternehmen zu akquirieren. Ziel sind dabei ausdrücklich keine Elefantenhochzeiten. Gesucht sind vielmehr kleinere Spezialisten, die das Portfolio von Infineon ideal ergänzen könnten. Um beispielsweise für die nächste Generation von Breitband-Kommunikationssystemen gerüstet zu sein, hatte Infineon im Jahr 2000 das Unternehmen Savan Communications erworben. Eine weitere strategische Akquisition: Zur Ergänzung des neuen Geschäftsbereichs Sichere Mobile Lösungen wurde im Geschäftsjahr 2002 das Kerngeschäft der Chip-Sparte von Ericsson übernommen, die zu den größten Herstellern von Mikroelektronik für Mobilfunk-Basisstationen, Wireless LAN-Netzwerken und Bluetooth-Anwendungen gehört. Zum Übernahmevertrag gehört eine Entwicklungskooperation mit Ericsson für heutige und zukünftige Mobilfunklösungen der Generationen 2.5 G und 3 G. Gleichzeitig gewinnen wir mit Ericsson einen wichtigen Abnehmer unserer Produkte und Lösungen für Handys und Netzwerk-Infrastruktur.

Auf dem Weg hin zu mehr strategischen Partnerschaften ist Infineon ein gutes Stück vorangekommen. Zusammen mit AMD und DuPont beispielsweise errichtet Infineon in Dresden ein Zentrum, um die lithographischen Masken für die Chipherstellung der nächsten Generationen zu entwickeln und zu produzieren. Ferner hat Infineon mit Agere Systems und Motorola in den USA das Gemeinschaftsunternehmen StarCore LLC gegründet, das Digitalsignalprozessor (DSP)-Technologie entwickeln und vermarkten soll, die wesentlich für Mobiltelefone, Unterhaltungselektronik und Kommunikationssysteme ist und der hohe Wachstumsraten vorausgesagt werden.

Zudem lizenziert Infineon seine Speichertechnologie an den taiwanesischen Speicherchip-Hersteller Winbond und erhält im Gegenzug das exklusive Abnahmerecht für die damit produzierten Standard-Speicherchips. Hinzu kommen die jüngsten Verträge mit der Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) in China, der Kingston Technology Company, Inc. (USA), mit Agere Systems (USA) und dem Speicherchip-Hersteller Nanya (Taiwan), die unter „Trends & Themen“ ausführlicher beschrieben sind. Mit solchen Partnerschaften senkt Infineon seine Entwicklungskosten; die hohen Investitionen und Risiken beim Aufbau von neuen Produktionsstätten insbesondere der DRAM-Branche werden auf mehrere Schultern verteilt. Durch Lizenzvereinbarungen erhöht Infineon kostengünstig seine Produktionskapazitäten und kann seine eigene Technologie- und Kostenführerschaft weiter ausbauen.

Marktanteile hinzugewonnen

Aber vor allem auch unternehmensintern nutzt Infineon die Branchenkrise – etwa, um die Kostenpositionen durchgängig zu verbessern. Das Unternehmen hat sich mit dem Programm „Impact“ eine strenge Diät verordnet, die in Rekordzeit

Wir haben ehrgeizige Ziele:
Infineon hat klare Vorstellungen, wie sich das Unternehmen weiter verändern wird. Wir haben genau definiert, was wir in den nächsten fünf Jahren erreichen wollen – und das ist eine ganze Menge.

Einsparungen von rund 2,8 Milliarden Euro gebracht hat, davon 1,3 Milliarden Euro EBIT-wirksam. Inzwischen ist mit „Impact“ ein Nachfolgeprogramm implementiert, um langfristig noch effizienter, flexibler und schneller zu werden. Zudem hat Infineon auch in der kritischen Marktphase Marktanteile hinzugewonnen: so wurde die Nr. 1-Position im Markt für Chipkarten weiter ausgebaut. Bei der Automobilelektronik belegt Infineon jetzt uneingeschränkt Rang 1 in Europa und Rang 2 weltweit. Auch in den Bereichen mobile und drahtgebundene Kommunikation gehört Infineon zu den Top 3-Unternehmen. Bei Speicherprodukten haben wir in 2002 erstmals Platz 3 nach Samsung und Micron erreicht und unseren Konkurrenten Hynix überholt.

Für das weitere Wachstum hat sich Infineon mit China, Japan und den USA drei Schwerpunktregionen ausgewählt, die in der Zukunft steigenden Absatz erwarten lassen, während die führende Position in Europa und Asien weiter gestärkt werden soll. Infineon rüstet sich also erfolgreich für den kommenden Aufschwung des Halbleitermarktes – um dann in der Poleposition durchzustarten.

Wir schaffen Halbleiter-Lösungen, die den Technology Lifestyle des Menschen im 21. Jahrhundert ermöglichen.

Agenda 5-to-1



SPEICHERCHIPS: INFINEON SICHERT SICH PARTNERSCHAFT IN CHINA

Mit einer weiteren Kooperation mit der Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), Shanghai (China), sichert sich Infineon weitere Marktanteile bei Speicherchips. Beide Unternehmen haben vertraglich vereinbart, dass Infineon seine 0,14-Mikrometer-Fertigungstechnologie an SMIC transferiert und im Gegenzug das exklusive Abnahmerecht für die Speicherchips erhält, die mit dieser Technologie hergestellt werden. Vorgesehen ist zudem eine Option auf den Transfer des 0,11-Mikrometer-Fertigungsprozesses. Damit baut Infineon seine Position als drittgrößter Speicherchip-Hersteller weiter aus und positioniert sich im Wachstumsmarkt China. Das Marktforschungsinstitut Gartner Dataquest prognostiziert, dass der chinesische Halbleitermarkt von rund 16 Mrd. Euro in 2002 auf etwa 31 Mrd. Euro in 2006 wächst.

INFINEON UND NANYA: GEMEINSAM ZU NEUER TECHNOLOGIE UND CHIPFABRIK

Infineon kooperiert künftig mit dem Speicherchip-Hersteller Nanya (Taiwan): Am Standort Dresden werden die beiden Partner gemeinsam daran forschen, die Strukturen bei Speicherchips von heute 130 auf 90 und 70 Nanometer zu reduzieren. Zudem haben die Unternehmen ein 50:50-Joint Venture für eine neue 300-Millimeter-Fabrik in Taiwan gegründet, die Ende 2003 in Betrieb gehen wird und in der die neue Technologie bereits eingesetzt werden soll. Dabei lizenziert Infineon seine 300-Millimeter-Technologie an das Gemeinschaftsunternehmen. Abhängig vom Weltmarkt soll die Fabrik bis zum Jahr 2006 auf eine Kapazität von bis zu 50.000 Wafer-Starts monatlich ausgebaut werden. Damit wird die geplante Halbleiterfabrik, in die in den nächsten drei Jahren insgesamt rund 2,2 Mrd. Euro investiert werden sollen, eine der größten der Welt.



ERNEUT SESAMES-AWARD FÜR INFINEON

Anlässlich der „Cartes 2002“ in Paris, der weltweit bedeutendsten Messe für Chipkarten-Applikationen, ist Infineon zum zweiten Mal in Folge mit der höchsten Auszeichnung der Chipkarten-Branche, dem Sesames-Award, ausgezeichnet worden. Als „Beste technologische Innovation“ preisgekrönt wurden ein Sicherheitscontroller von Infineon und ein

gemeinsam mit Sony entwickelter Mikrocontroller für kontaktlose Chipkarten-Anwendungen, die unterschiedliche Funkstandards unterstützen können. Die Neuentwicklungen ermöglichen Chipkarten, die nicht in ein Lesegerät eingegeben werden müssen, sondern drahtlos per Funk mit dem Gerät kommunizieren. Sie lassen sich vielseitig als elektronische Tickets, Firmen- oder Behördenausweise und als Bankkarten einsetzen und ermöglichen sichere und zuverlässige Transaktionen.



INFINEON UND AGERE: ALLIANZ FÜR SCHNELLE DRAHTLOSE NETZWERK- LÖSUNGEN

Um leistungsfähige Chips für die kommende Generation drahtloser LAN-Netzwerke zu entwickeln, haben sich Infineon und das US-amerikanische Unternehmen Agere Systems auf eine weitreichende Allianz geeinigt. Im Vergleich zu bisherigen drahtlosen Netzwerken ergibt sich eine um den Faktor 20 höhere Bandbreite von bis zu 54 Megabit pro Sekunde. Solche LAN-Systeme ermöglichen in Unternehmensnetzwerken, Multimedia- oder Heim-Applikationen schnellen Zugriff auf E-Mail und Internet. Die Zusammenarbeit von Infineon und Agere betrifft die wechselseitige Lizenzierung von Intellectual Property und eine gegenseitige Liefervereinbarung. Vermarkten wollen die Unternehmen die Produkte unabhängig voneinander.

INFINEON LIEFERT SPEICHERPRODUKTE AN KINGSTON

Um ihre Marktpositionen bei Speicherprodukten zu stärken, bauen Infineon und die kalifornische Kingston Technology Company, Inc. ihre langjährige Partnerschaft aus. Unterzeichnet wurde ein langfristiger Vertrag, nach dem Infineon Speicherchips an Kingston liefern wird, der die Chips auf Module packt und überwiegend über den Retail-Markt veräußert. Damit will Infineon in den nächsten fünf Jahren kumulativ bis zu 2,5 Mrd. US-Dollar Umsatz erzielen. Hinzu kommt eine unverbindliches Abkommen (Memorandum of Understanding), nach dem Kingston als Auftragsfertiger für Infineon arbeiten und technische Dienstleistungen für die Back-End-Fertigung erbringen soll.

GUTE UNTERNEHMENSFÜHRUNG ALS GANZHEITLICHES KONZEPT

Infineon verabschiedet eigenen Corporate Governance Kodex und geht dabei über die Vorgaben der Regierungskommission hinaus

Infineon hat einen eigenen Corporate Governance Kodex verabschiedet. Damit werden die Grundsätze einer guten und wertorientierten Unternehmensführung stärker institutionalisiert; zudem wurde ein Beauftragter für Corporate Governance berufen, der direkt an Vorstand und Aufsichtsrat berichtet. Der Kodex richtet sich stark an den Empfehlungen der Regierungskommission aus, mit denen die deutsche Bundesregierung auf Vergehen einzelner Unternehmen reagiert hat.

Infineon versteht Corporate Governance als ganzheitliches Konzept, das alle unternehmerischen Werte, Prozesse und Ziele einschließt. Dazu zählen die Standards des internen Controllings ebenso wie die Leitlinien für das unternehmerische Verhalten im Wettbewerb, die „Business Conduct Guidelines“. Integriert sind zudem die Leitlinien, die die Organisations- und Aufsichtspflichten des Unternehmens betreffen.

Infineon hatte bereits zuvor den größten Teil der im Kodex verankerten Regeln eingehalten, ebenso die Gesetze des US-amerikanischen Kapitalmarktes. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen mit dem Kodex weiter gehende eigene Ziele gesteckt:

- Wir informieren unsere Aktionäre und die Öffentlichkeit umfassend und offen über das Unternehmen, wobei wir im Vergleich mit dem Wettbewerb eine Spitzenstellung bei der Berichterstattung halten und ausbauen.
- Wir wollen die Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere in der Hauptversammlung, soweit wie möglich unterstützen und erleichtern. Dafür setzen wir neue Kommunikationslösungen ein, beispielsweise über das Internet.

■ Wir wollen die Zusammenarbeit und Beratung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat noch weiter stärken. Wir sind einerseits zutiefst davon überzeugt, dass das deutsche System der Trennung von Unternehmensführung durch den Vorstand und Unternehmenskontrolle durch den Aufsichtsrat beste Voraussetzungen für gute Corporate Governance bietet. Andererseits erreichen wir unsere Ziele nur durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und Beratung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Dabei wollen wir ein Klima offener Gespräche im gegenseitigen Respekt weiter fördern.

■ Die Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden ist nur möglich mit fähigen und engagierten Menschen. Vorstand und Aufsichtsrat sehen es als gemeinsame Aufgabe an die fähigsten Menschen für das Unternehmen zu gewinnen und zu halten.

Auch die zusätzlichen Anregungen der Regierungskommission sind bei Infineon weitestgehend umgesetzt, Abweichungen gibt es in den beiden folgenden Punkten:

■ Die Vergütung des Vorstands wird getrennt nach festen und variablen Bestandteilen und Aktienoptionen veröffentlicht, allerdings nicht weiter individualisiert. Hauptgrund hierfür ist die gemeinschaftliche Verantwortung aller Mitglieder des Vorstands für die Unternehmensführung. Diese Lösung war bereits in den Vorjahren Bestandteil der transparenten Berichterstattung von Infineon und beschreibt das erfolgs- und leistungsorientierte Vergütungssystem des Unternehmens als wichtigen Baustein für eine ergebnisorientierte Unternehmensführung. Der variable Vergütungsbestandteil ist bei Vorstand und Mitarbeitern an das Erreichen konkreter Erfolgsziele geknüpft. Zusätzlich zur Ver-

gütung erhalten der Vorstand sowie ausgewählte Führungskräfte von Infineon Aktienoptionen, die einen langfristig orientierten Anreiz zur nachhaltigen Steigerung des Aktienkurses bilden.

■ Der Aufsichtsratsvorsitzende ist auch Vorsitzender des Prüfungsausschusses.

Bei Infineon umfasst das Corporate Governance-System das gesamte Unternehmen und richtet sich an seinen Zielen aus: Seiner neuen Mission entsprechend strebt Infineon an, modernste Halbleiter-Lösungen und dazugehörige Dienstleistungen zu schaffen, um langfristig die Branchenführerschaft zu übernehmen. Oberstes Gebot ist dabei die Kundenorientierung, um einen Mehrwert zu produzieren, von dem die Kunden ebenso wie die Aktionäre profitieren. Dabei verfolgt Infineon die Vision, den Technology Lifestyle des 21. Jahrhunderts zu schaffen.

Das Corporate Governance-Regelwerk von Infineon soll ständig überprüft und weiterentwickelt werden, es soll aktiv im Unternehmen gelebt werden. Wörtlich heißt es in dem Papier: „Wir suchen den Dialog mit unseren Aktionären, Kunden und Mitarbeitern, um diesen Kodex regelmäßig zu überprüfen und ihn im Lichte neuerer Entwicklungen fortzuentwickeln, und um mit ihm eine Spitzenstellung bei der wertorientierten Unternehmensführung zu erreichen und zu halten.“

Damit kann Infineon die Ziele erreichen, die es sich gesteckt hat – und zu den Unternehmen mit der besten Corporate Governance gehören.

Der vollständige Text und weitere Informationen stehen im Internet unter: www.infineon.com/comp/corporate-governance



JUNGFORSCHER KNACHT GESCHWINDIGKEITSREKORD

Der für Infineon tätige 26-jährige Doktorand Daniel Kehrer hat einen neuen Geschwindigkeits-Weltrekord aufgestellt: Mit einem experimentellen Halbleiter-Schaltkreis hat er eine Datenübertragung von 40 Milliarden Bit pro Sekunde in CMOS-Bauelementen ermöglicht und verdoppelte damit nahezu die Bestmarke vom Februar 2002, als Infineon mit 25 Gigabit pro Sekunde ebenfalls einen Weltrekord erreicht hatte. Mit dem geschwindigkeitsoptimierten Chip lassen sich schon bald kostengünstiger noch leistungsfähigere Chips für Kommunikationsnetzwerke mit PCs, Mobiltelefonen und Automobil- und Industrieanwendungen herstellen. Das Forschungsergebnis ist ein Resultat aus einem der gezielten Nachwuchsförderung, zum anderen der ausgereiften Mikrochip-Technologie von Infineon. Die Abteilung für Hochfrequenz-Forschung von Infineon beschäftigt genauso wie viele andere Bereiche immer wieder Doktoranden, die sich mit neuestem Hochschulwissen ausgestattet mit viel Elan in die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des Halbleiter-Konzerns einbringen.

EINFACHER CHAT PER MOBILTELEFON: NEUE SYSTEMLÖSUNG

Infineon hat seine Mobilfunk-Systemlösung um eine neue Komponente bereichert: Mit der Instant Communications Plattform des neuen Partners Sonim können Nutzer von Mobiltelefonen beispielsweise mit ihrem Adressbuch feststellen, ob ein Freund oder Kollege für ein Gespräch verfügbar ist. Ist das der Fall, kann das Gespräch einfach per Knopfdruck (push-to-talk) begonnen werden. Der Anwender kann auch verschiedene Nummern auswählen und mit den Teilnehmern sofort eine Chat-ähnliche Kommunikationsrunde eröffnen. Darüber hinaus können Sprachmitteilungen an eine oder mehrere Personen gesendet werden, ohne das Mobiltelefon oder die Mailbox anrufen zu müssen. Infineon erweitert mit der Sonim-Lösung seine eigene Entwicklungsumgebung APOXI™. Somit kann Infineon seinen Kunden im Sinne der neuen Unternehmensstrategie eine innovative Systemlösung anbieten und erzielt einen Wettbewerbsvorsprung im Mobilfunkmarkt.

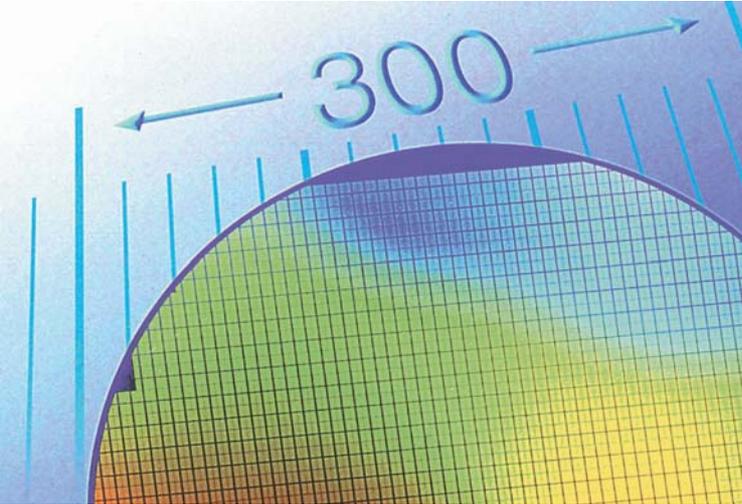
CHIP KÖNNTE STRICHCODE ERSETZEN

Der Strichcode auf Verpackungen von Lebensmitteln und anderen Waren könnte bald der Vergangenheit angehören: Infineon ist es jetzt erstmals gelungen, elektronische Schaltkreise auf handelsübliche Verpackungsfolie aufzubringen. Was bislang nur mit hochwertigen Kunststoffen möglich war, kann nun kostengünstig produziert werden. Ähnlich wie beim Zeitungsdruck läuft die Folie in Hochgeschwindigkeit durch mehrere Beschichtungs- und Strukturierungsvorgänge. Die Chips selbst basieren auf halbleitend dotierbaren Polymeren; es handelt sich also um Kunststoff-Chips. Der Halbleiter braucht keine Sichtverbindung zum Lesegerät mehr, er übermittelt seine Informationen per Funk quasi im Vorbeigehen. Sollte sich die Technologie durchsetzen und möglichst jeder neu produzierte Artikel damit ausgestattet werden, ist ein jährliches Produktionsvolumen von 500 Milliarden Stück denkbar.



Infineon integriert erstmals Plastik-Chips auf handelsüblicher Verpackungsfolie. Die Funk-Etiketten benötigen keine Sichtverbindung zum Lesegerät und könnten damit zukünftig Barcodes ersetzen.

DURCHBRUCH: KOSTENVORSPRUNG MIT DER 300-MILLIMETER-TECHNOLOGIE



Nur ein Jahr, nachdem Infineon in Dresden im Dezember 2001 als weltweit erster Halbleiterhersteller die Volumenproduktion auf 300-Millimeter-Wafern aufgenommen hat, rentiert sich die Fertigung: Der so genannte Cost-Cross-Over-Punkt ist überschritten, und damit produziert Infineon Speicherchips ab sofort günstiger mit der neuen Generation als auf den bisher üblichen 200-Millimeter-Wafern. Auf die pizzagroße Grundfläche der 300-Millimeter-Wafer passen gegenüber 200-Millimeter-Wafern etwa zweieinhalbmal so viele Chips; die Produktionskosten werden durch diese Technologie um 30 % verringert. Hinzu kommt das Chip-Shrinking, also die Verkleinerung der Chipstrukturen. Voraussichtlich bis Ende 2003 wird das neue dritte Fertigungsmodul in Dresden seine volle Fertigungskapazität von 6.000 Wafer-Starts pro Woche erreichen – derzeit werden rund 5.000 Wafer wöchentlich in 300-Millimeter-Technik gefertigt. Die relativ kurze Zeit zwischen dem Beginn der Volumenfertigung und dem Cost-Cross-Over verdankt Infineon einem ehrgeizigen Zeitplan und hervorragendem Projektmanagement.



ALLES AUF EINE KARTE: GELDBÖRSE, FAHRKARTE UND AUSWEIS

Elektronische Alleskönner sind die neuen Chipkarten-Controller, die Infineon auf der Pariser Chipkarten-Messe „Cartes 2002“ präsentiert hat. Vorgestellt wurden zum einen die mit Sony entwickelten Dual-Interface-Controller und zum anderen erste Mitglieder der my-C-Familie von Sicherheits-Controllern von Infineon. Karten, die mit solchen Controllern bestückt sind, können sowohl für elektronische Tickets und Bankenkarten als auch für Firmen- oder Behördenausweise eingesetzt werden. Ihre kontaktlose Schnittstelle macht die Anwendung für den Verbraucher bequemer, da sie nicht in ein Lesegerät eingeschoben werden müssen.

INTELLIGENTES AUTOKENNZEICHEN SCHÜTZT VOR AUTODIEBEN

Die blechernen Nummernschilder könnten bald um ein elektronisches Autokennzeichen ergänzt werden. Das Etikett namens „iltag“, das auf der Innenseite der Windschutzscheibe aufgeklebt wird, ist etwa so groß wie ein Personalausweis, enthält sichtbare Informationen wie die Zeichenkombination des Nummernschildes und speichert daneben bis zu 1.000 Zeichen in einem Chip, etwa die Namen aller berechtigten Fahrer, Steuer- und Versicherungsnachweise und Daten des Fahrzeugscheins. Entwickelt wurde das Schild, dessen Daten nur autorisierte Stellen wie Zulassungsbehörden oder die Polizei ein- und auslesen können, von den drei in Deutschland ansässigen Unternehmen Infineon Technologies, Schreiner Prosecure und Utsch. Da sich beim Ablöseversuch des „iltag“ sowohl die Sicherheitsfolie als auch die Verbindung zwischen Chip und Antenne zerstören, ist er nicht auf andere Fahrzeuge übertragbar.



Die auf dem Chip gespeicherten Daten lassen sich mit Hilfe eines Hand-Lesegerätes kontaktlos auslesen.



BEREICH SPEICHERPRODUKTE ZURÜCK IN DER GEWINNZONE

Zahlen für das erste Quartal: 10 % Umsatzwachstum im Gesamtunternehmen/
Neuer Rekordumsatz bei Automobil- und Industrieelektronik

Infineon geht mit höheren Umsätzen ins neue Geschäftsjahr. Im ersten Quartal, also von Oktober bis Dezember 2002, setzte das Unternehmen 1,52 Mrd. Euro um, das sind 10 % mehr als im Quartal zuvor und 47 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Zum einen sind es Speicherchips, die höhere Umsätze verzeichnen, zum anderen Halbleiter-Lösungen für Mobiltelefone; anhaltend gut ist zudem der Absatz für Automobil- und Industrieelektronik. Erstmals eingerechnet sind außerdem die Umsätze der von Ericsson im September 2002 übernommenen Halbleitersparte.

Vor allem, da es Infineon gelungen ist, den japanischen Markt weiter zu durchdringen, stieg der außereuropäisch erwirtschaftete Umsatzanteil auf 54 % vom Gesamtumsatz. Insgesamt konnte Infineon Marktanteile hinzugewinnen, die sich weiter positiv auswirken werden, sobald sich der Markt erholt.

Im Geschäftsbereich Speicherprodukte ist zudem die Rückkehr in die Gewinnzone zu vermelden – hier tragen die optimierte Preisgestaltung und der verbesserte Produkt-Mix sowie die beträchtlich reduzierten Vollkosten Früchte.

Das Quartalsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wurde erheblich verbessert und lag nun bei minus 31 Mio. Euro, gegenüber einem Minus von 292 Mio. Euro im vorherigen Quartal, in dem Sonderbelastungen in Höhe von 119 Mio. Euro angefallen waren, und einem Minus von 564 Mio. Euro im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2002. Auch hier zählt sich in erster Linie aus, dass mittels der 300-

Millimeter-Technologie und Verkleinerung der Chipstrukturen die Kosten im Segment Speicherprodukte erheblich gesenkt wurden; zudem haben sich die Umsätze hin zu Produkten mit höheren Margen verlagert. Der Verlust pro Aktie belief sich nur noch auf 0,06 Euro gegenüber 0,72 Euro im vorausgegangenen Quartal und 0,48 Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

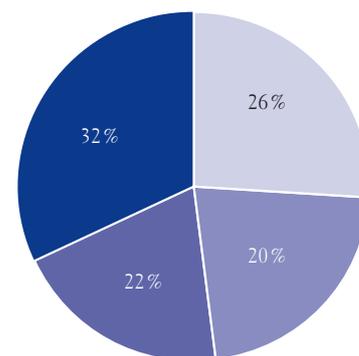
Gleich bleibend investiert hat Infineon in Forschung und Entwicklung – die FuE-Aufwendungen beliefen sich auf 265 Mio. Euro oder 17 % vom Umsatz gegenüber 292 Mio. Euro im Vorquartal.

Zurückgegangen ist die Cash Position, von zwei Mrd. Euro im vorherigen Quartal auf 1,6 Mrd. Euro. Wesentliche Gründe dafür sind Investitionen in die 300-Millimeter-Volumenproduktion, die Umstellung auf die nächstkleinere Strukturgröße von 0,11-Mikrometer sowie der Aufbau von Lagerbeständen hauptsächlich im Bereich Speicherprodukte und der umsatzbedingte Anstieg der Außenstände.

Der außerhalb Europas erwirtschaftete Umsatz erreichte einen Anteil von 54 % am Gesamtumsatz gegenüber 53 % im vorausgegangenen Quartal. Diese Entwicklung spiegelt die zunehmende Marktdurchdringung von Infineon in Asien und Japan wider.

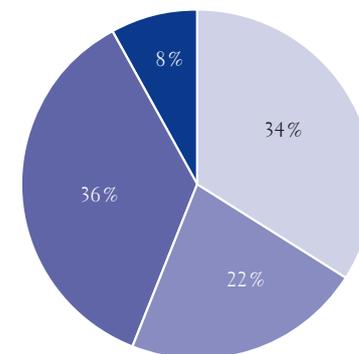
Zum 31. Dezember 2002 beschäftigte Infineon weltweit ca. 30.900 Mitarbeiter, davon etwa 5.400 in Forschung und Entwicklung.

Regionale Umsatzverteilung in Prozent für das Quartal zum 31.12.02



- Deutschland
- Restliches Europa
- Amerika (NAFTA)
- Asien/Pazifik

Segment-Umsatzerlöse in Mio. Euro für das Quartal zum 31.12.02



- Kommunikation: 518 Mio. Euro
- Automobil- und Industrieelektronik: 334 Mio. Euro
- Speicherprodukte: 542 Mio. Euro
- Sonstige und Konzernfunktionen: 129 Mio. Euro

Infineon: 1.523 Mio. Euro

Aus der Taufe gehoben wurde im vergangenen Quartal ein neuer Geschäftsbereich: Zum 1. November 2002 hat Infineon die Bereiche Mobile Kommunikation und Sicherheits- & Chipkarten-ICs zusammengefasst als Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen – ein Schritt, der vor allem mit der zunehmenden Konvergenz der Märkte für mobile und sichere Applikationen einhergeht. Das zeichnet sich beispielsweise bei künftigen Generationen im Mobilfunk ab, für die aufgrund der steigenden Anzahl von Multimedia-Anwendungen die sichere Datenübertragung zusehends an Bedeutung gewinnt. Zudem sollen so Synergieeffekte ausgelöst werden und zunehmend Systemlösungen vorangetrieben werden, wie es die neue Unternehmensstrategie „Agenda 5-to-1“ vorsieht.

Der neue Geschäftsbereich ist mit einem Umsatzanstieg im ersten Quartal von 11 % auf 412 Mio. Euro gestartet, hauptsächlich durch das starke Weihnachtsgeschäft mit Mobiltelefonen. Darüber hinaus wurden erstmals die Umsätze der von Ericsson übernommenen Microelectronics-Segmente berücksichtigt. Das EBIT lag bei minus 28 Mio. Euro gegenüber minus 22 Mio. Euro im Vorquartal, vor allem, weil weniger Chipkarten-Chips abgesetzt wurden, auf denen zugleich starker Preisdruck lastet. Hinzu kamen 34 Mio. Euro an operativen Verlusten und Aufwendungen für die Integration der Ericsson-Sparten.

AUSGEWÄHLTE DATEN DER QUARTALS-KONZERN-GEWINN-UND-VERLUSTRECHNUNG

	3 MONATE ZUM	
	30.09.02	31.12.02
in Mio. Euro		
Umsatzerlöse	1.384	1.523
Umsatzkosten	-1.241	-1.121
Bruttoergebnis vom Umsatz	143	402
Forschungs- und Entwicklungskosten	-292	-265
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten	-163	-172
Betriebsergebnis	-318	-43
Konzernfehlbetrag	-506	-40
Konzernfehlbetrag je Aktie	-0,72	-0,06
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	-292	-31

Der Umsatz lag mit 1,52 Mrd. Euro um 10 % über dem letzten Quartal und um 47 % über dem Vorjahresquartal. Der Umsatzanstieg basierte auf gesteigerter Nachfrage nach Speicherprodukten und Chips für die mobile Kommunikation. Das EBIT verbesserte sich im ersten Quartal deutlich auf minus 31 Mio. Euro, nach minus 292 Mio. Euro im Vorquartal und minus 564 Mio. Euro im Jahresvergleich.

AUSGEWÄHLTE KONZERN-BILANZDATEN

	ZUM	
	30.09.02	31.12.02
in Mio. Euro		
Zahlungsmittel	1.199	851
Umlaufvermögen abzüglich der kurzfristigen Verbindlichkeiten exklusive Zahlungsmittel	609	941
Bilanzsumme	10.918	10.766
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sowie kurzfristig fällige Bestandteile langfristiger Finanzverbindlichkeiten	120	108
Langfristige Finanzverbindlichkeiten ohne kurzfristig fällige Bestandteile	1.710	1.712
Summe Eigenkapital	6.158	6.071

Der höhere Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit resultiert aus Investitionen in unsere 300-Millimeter-Fertigung in Dresden.

AUSGEWÄHLTE DATEN DER QUARTALS-KAPITALFLUSSRECHNUNG

	3 MONATE ZUM	
	30.09.02	31.12.02
in Mio. Euro		
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-120	-340
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	179	4
Abschreibungen	354	353

Der Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik vermeldete abermals einen Rekordumsatz: Gegenüber dem vorherigen Quartal stieg der Umsatz um 4% und erreichte 334 Mio. Euro, vor allem, da mehr Netzteil- und Stromversorgungsprodukte abgesetzt wurden, ebenso wie Leistungshalbleiter für Kfz. Dabei ist es Infineon auch gelungen, seine innovativen 32-Bit-TriCore-Microcontroller bei den Kunden zu platzieren, und besonders in Asien sicherte sich das Unternehmen zusätzliche Marktanteile im Bereich Stromversorgung. Außerdem zahlt sich die Restrukturierung des Segments Sensoren bereits mit höheren Umsätzen aus. Das EBIT lag bei 44 Mio. Euro, gegenüber 38 Mio. Euro im Vorquartal und 20 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Erreicht wurde das, indem Kosten gesenkt wurden; gesteigert wurde zudem die Produktivität, und dies alles trotz des beträchtlichen Preisdrucks in der Automobilindustrie.

Der Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation steigerte den Umsatz im abgelaufenen Quartal leicht auf 106 Mio. Euro. Das entspricht einem Anstieg von einem Prozent gegenüber dem vorausgegangenen Quartal und von 28% gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Gestiegen ist dabei vor allem der Absatz der Ethernet-over-VDSL-Zugangs-

technologie in den asiatischen Märkten. Das EBIT verbesserte sich von minus 45 Mio. Euro im vorausgegangenen Quartal auf minus 42 Mio. Euro. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum hatte das EBIT noch bei minus 85 Mio. Euro gelegen.

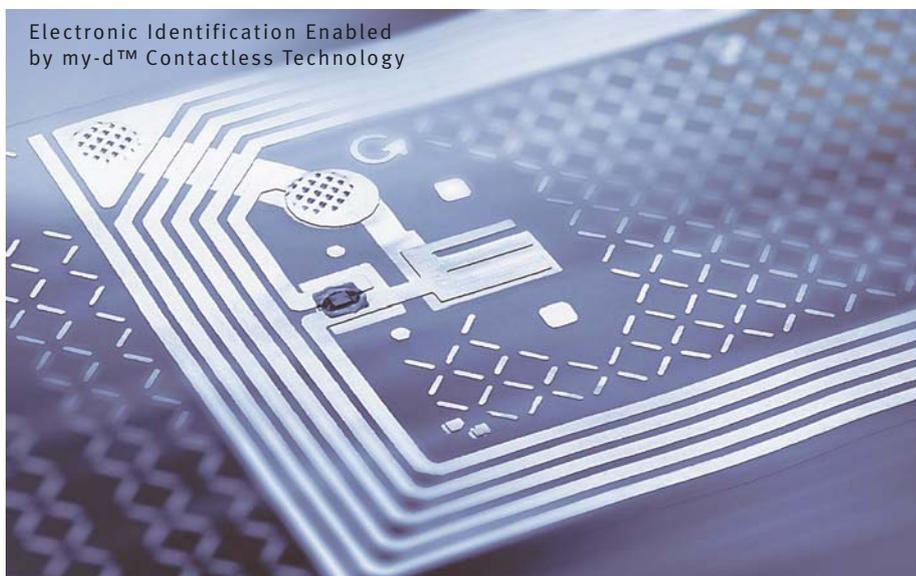
Der Geschäftsbereich profitiert dabei besonders vom beträchtlich gestiegenen Umsatzvolumen sowie von Kostensenkungen. So konnte Infineon seine Position in den asiatischen Märkten als führender Anbieter von High-Speed-VDSL-Zugangstechnologie der nächsten Generation ausbauen. Dabei waren die Marktbedingungen schwierig: Bei den globalen Netzbetreibern sind die Infrastruktur-Investitionen weiterhin rückläufig, was insbesondere einer Nachfrageerholung bei Glasfaser- und optischen Netzwerk-Komponenten entgegensteht.

Der Geschäftsbereich Speicherprodukte meldet sich in der Gewinnzone zurück. Mit 542 Mio. Euro ist auch ein stattliches Umsatzwachstum zu verzeichnen – um 24% gegenüber dem Vorquartal; gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal hat sich der Absatz mit 89% sogar fast verdoppelt. Dabei wirken sich neben der allgemein erhöhten Nachfrage die kürzlich getroffenen Lieferabkommen aus, beispielsweise mit Winbond. Das EBIT lag

bei positiven 29 Mio. Euro – gegenüber minus 204 Mio. Euro im Quartal zuvor und minus 375 Mio. Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Hier wirken vor allem die gesunkenen Herstellungskosten und der verbesserte Produkt-Mix. In der 300-Millimeter-Produktion am Standort Dresden hat Infineon den so genannten Cost-Cross-Over erreicht. Weit fortgeschritten ist zudem die Umstellung auf die 0,14-Mikrometer-Technologie; weiterhin hat Infineon sein Netzwerk für Fertigungskooperationen ausgebaut.

Eine Kooperation muss indes aufgegeben werden – da Mosel Vitelic Verträge wiederholt massiv gebrochen hat, hat Infineon beschlossen, sich aus dem Joint Venture ProMOS in Hsinchu, Taiwan, zurückzuziehen; seit dem 1. Januar 2003 bezieht Infineon keine ProMOS-Produkte mehr, die Anteile werden verkauft. Die führende Marktposition von Infineon im DRAM-Segment wird mit dieser Entscheidung nicht beeinträchtigt: Zurzeit baut Infineon in Taiwan neue Partnerschaften mit Nanya und Winbond auf und verbessert gleichzeitig Produktivität und Kostenposition.

Zusätzliche Finanzinformationen sind im Internet unter www.infineon.com/bourse verfügbar.



Standesgemäß für Infineon:

Zur ordentlichen Hauptversammlung, die am 21. Januar in München stattfand, gab es Eintrittskarten mit integriertem Infineon-Chip. Das so genannte „my-d Smart Label“ aus dem Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen (SMS) hat die Teilnehmer zur HV registriert – drahtlos, schnell und bequem.

AUSBLICK BIS JUNI 2003

Trotz erster Anzeichen für einen positiven Markttrend – Infineon kann noch nicht von einer nachhaltigen Verbesserung des Gesamtmarktes sprechen. Zwar sehen wir der Zukunft mit vorsichtigem Optimismus entgegen und erwarten in den meisten Segmenten eine weiterhin stabile Nachfrageentwicklung. Doch wir gehen auch davon aus, dass in unseren Geschäftsbereichen Drahtgebundene Kommunikation und Sichere Mobile Lösungen die schwierigen Marktbedingungen mit kontinuierlichem Preisdruck während der ersten Jahreshälfte anhalten werden.

Wir erwarten für 2003 eine erhöhte Nachfrage nach Mobiltelefonen, wobei nach dem starken Weihnachtsgeschäft 2002 im zweiten Quartal des Geschäftsjahres bis Ende März geringere Umsätze zu erwarten sind. Eine saisonale Nachfrageschwäche wird wohl auch das Marktsegment für Sicherheits- und Chipkarten-ICs treffen, hinzu kommt der hohe Preisdruck bei Sicherheits-Controllern für die mobile Kommunikation. Für die zweite Hälfte des Kalenderjahres 2003 geht Infineon jedoch davon aus, dass sich die allgemeinen Marktbedingungen bessern.

Marktanalysten gehen davon aus, dass die Investitionen für globale Telekommunikations-Infrastruktur auch im Jahr 2003 um rund 10% zurückgehen werden, nachdem der Markt im Jahr 2002 bereits um etwa 37% geschrumpft ist. Vor allem in den Bereichen Glasfaser und optische Netzwerke wird sich dies auch auf das Geschäft von Infineon auswirken. Dagegen stellt sich das Geschäft mit DSL-Lösungen zunehmend dynamisch dar. Infineon erhofft sich dabei Zuwächse besonders in Japan und allgemein in Asien.



Wir erhöhen das Tempo. Infineon wird noch schneller, effizienter und flexibler als je zuvor. Wir konzentrieren uns in Zukunft auf maßgeschneiderte Produkte und Lösungen, die den Erfolg unserer Kunden unterstützen.

In der Automobil- und Industrieelektronik will Infineon seine Marktanteile weiter ausbauen – und das trotz des starken Preisdrucks, dem Infineon Produktivitätssteigerungen und eine führende Produktperformance entgegenzusetzen hat. Die Produktsegmente Leistungshalbleiter und Stromversorgung werden voraussichtlich das größte Wachstum verzeichnen.

Die Nachfrage nach Speicherchips wird in den nächsten Monaten voraussichtlich nur leicht steigen – nach der robusten Umsatzentwicklung im ersten Quartal, in das auch die Weihnachtssaison fiel. Die Preisentwicklung hängt dabei nicht zuletzt von der Marktpsychologie und dem Verhalten der Endverbraucher ab. Dass sich die Preise im Verlauf des Kalenderjahres 2003 nachhaltig verbessern, setzt eine höhere Nachfrage der Unternehmen und eine Steigerung der Investitionen in die Infrastruktur voraus.

„Wir gehören zu den ersten, die mit Speicherchips wieder Geld verdienen. Die kontinuierliche Investition in die 300-Millimeter-Technologie zahlt sich jetzt aus. Wir sind zuversichtlich, dass wir durch unser erfolgreiches Programm zur Verkleinerung der Strukturgrößen und den Ausbau unserer strategischen Fertigungskooperationen weitere Marktanteile gewinnen werden und Infineon in der absehbaren Zukunft als einen der drei Top-Player im globalen DRAM-Markt etablieren können“, so Infineon-Chef Schumacher.

BEKENNTNIS ZU ALLEN GESCHÄFTSBEREICHEN

Hauptversammlung 2003 in München

Auf der Hauptversammlung von Infineon, die am 21. Januar in der Münchner Olympiahalle stattfand, bekannte sich Infineon-Chef Schumacher zu allen Geschäftsbereichen. Alle vier konnten im vergangenen Geschäftsjahr Marktanteile gewinnen und seien weiter auf dem Vormarsch.

Schumacher verwies gegenüber den 3.350 Aktionären darauf, dass sich die wichtigsten Geschäftszahlen des Konzerns deutlich verbessert haben. Obwohl der Markt stagniere, sei Infineon im vergangenen Geschäftsjahr mit 13 % zweistellig gewachsen. Mehrere Kleinaktionäre hatten in der Generaldebatte kritisiert, dass der Wert der Infineon-Aktie seit ihrem Höchststand Mitte 2000 um 90 % zurückgegangen ist. Der Vorstand verwies darauf, dass ausnahmslos alle Halbleiter-Aktien ähnliche Kursverluste hätten hinnehmen müssen. Infineon habe mit seinen Kostensenkungsprogrammen angemessen reagiert – 2,8 Mrd. Euro konnten bisher eingespart werden, davon 1,3 Mrd. Euro EBIT-wirksam. Zudem richte sich Infineon mit seiner

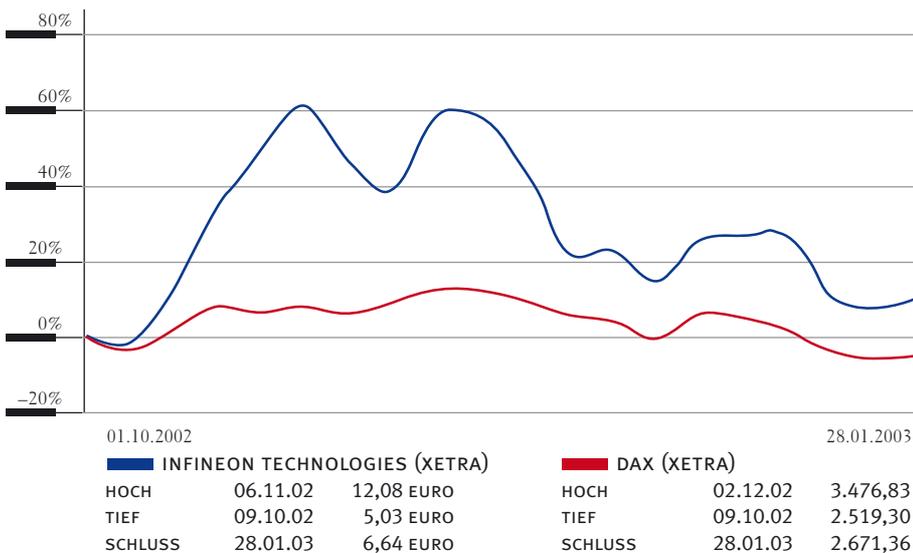
neuen Unternehmensstrategie „Agenda 5-to-1“ neu für die Zukunft aus.

Schumacher verwies auf den fortgesetzten Konzentrationsprozess in der Halbleiter-Industrie. Es sei zu erwarten, dass langfristig nur vier bis fünf Hersteller pro Marktsegment erfolgreich sein können. Infineon plant, in allen Geschäftssegmenten zu den ersten drei der Welt zu gehören und hat wesentliche Zwischenziele vor allem auch bei Speicherprodukten bereits erreicht.

Erneut kritisierte Schumacher, dass der südkoreanische Halbleiter-Hersteller Hynix durch staatsnahe Banken am Leben erhalten wird, der Wettbewerb damit verzerrt werde. Das wirke sich negativ auf die Preise für Speicherchips aus und mache der gesamten Industrie das Leben schwer. Schumacher weiter: „Für den Aufschwung sind wir mit unserer 300-nm-Technologie mit einem Zeitvorsprung von etwa ein bis zwei Jahren in der Volumenproduktion gegenüber unseren Konkurrenten bestens gerüstet. Ich denke schon, dass wir (bis Ende des Jahres) die Talsohle durchschritten haben werden.“

Auf der Hauptversammlung wurde unter anderem nahezu einstimmig beschlossen, die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat für das vergangene Geschäftsjahr zu entlasten. Zugestimmt wurde zudem dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der EUPEC Europäische Gesellschaft für Leistungshalbleiter mbH, die zu 100 % zu Infineon gehört. Mit 229.781.371 Aktien waren 31,88 % vom stimmberechtigten Grundkapital vertreten.

Relative Performance der IFX-Aktie seit Beginn des GJ 02/03



Hinweis:

Dieses Dokument enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Infineon beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u. a.: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Infineon ist weder geplant noch übernimmt Infineon die Verpflichtung dazu.

INFINEON KALENDER

- KW18 Veröffentlichung der Ergebnisse für das 2. Quartal und das erste Halbjahr (bis 31. März) des Geschäftsjahres 2003
- KW30 Veröffentlichung der Ergebnisse für das 3. Quartal (bis 30. Juni) des Geschäftsjahres 2003

Messen und Ausstellungen

- 18.–20.02.03 Embedded World/ Nürnberg
- 12.–19.03.03 CeBIT/Hannover
- 17.–19.03.03 CTIA World of Wireless Communications/ New Orleans
- 25.–27.03.03 OFC Optical Fiber Communications/Atlanta
- 14.–16.04.03 RSA Conference/ San Francisco

IMPRESSUM

INVESTOR NEWSLETTER 4/2003

Herausgeber

Infineon Technologies AG

Investor Relations und

Finanzkommunikation

Postfach 80 09 49

81609 München

Tel.: +49 89 234-26655

Fax: +49 89 234-9552987

E-Mail: investor.relations@infineon.com

www.infineon.com/boerse

Redaktion

Katja Bürkle, Verena Raab,

Achim Schneider (verantwortlich)

Gestaltung

OgilvyOne worldwide GmbH & Co. KG,

Frankfurt am Main